



M-86 厚膜镜面铝 COB

M-86 镜面铝 COB 选择的是厚膜丝网印刷工艺，将特殊的绝缘体和银层浆料（专利产品）丝印到镜面铝基体上并进行高温烧结。M-86 是为了满足对价格有极低要求的客户，选择的基体是 86%的反色镜面铝。

主要特性指标：

导热特性：> 200 W/m.K

温度特性：290 度 10S 不分层。190C，1000 小时老练未发生异常（银层需要防护，以免氧化）

银层金丝键合：推力大于 55g

银层焊接特性：可焊

绝缘特性：大于 1000VAC

光通量数据 (Φ)：902 lm

光效数据 (η)：101 lm/w

其他特点：该镜面铝 COB 弯曲之后，依然能保证线路良好的导电性。可以自由设计。

M-98 厚膜镜面铝 COB

M-98 镜面铝 COB 选择的是厚膜丝网印刷工艺，将特殊的绝缘体和银层浆料（专利产品）丝印到镜面铝基体上并进行高温烧结。M-98 镜面铝 COB 的优势是在保证与传统工艺制作的镜面铝 COB 同样的光效前提下，能够大幅度的降低使用者的成本。选择的基体的 98%高反色镜面铝。

主要特性指标：

导热特性：> 200 W/m.K

温度特性：290 度 10S 不分层。190C，1000 小时老练未发生异样（银层需要防护，以免氧化）

银层金丝键合：推力大于 55g

银层焊接特性：可焊

绝缘特性：大于 1000VAC

光通量数据 (Φ)：1112 lm

光效数据 (η)：121 lm/w

其他特点：该镜面铝 COB 弯曲之后，依然能保证线路良好的导电性。可以自由设计。